



Technicien packaging et procédés semiconducteur back-end - F/H

Ref : 2022-MT1

Envie d'aventure au sein d'une start-up qui booste l'industrie de l'imagerie ?

L'entreprise:

SILINA est une start-up qui a levé des fonds de plusieurs millions d'euros **afin de faire naître la nouvelle génération des systèmes de vision** grâce à une **technologie qui permet de courber des capteurs d'imagerie (e.g CMOS)**.

Cette **innovation importante** dans le domaine semiconducteur deviendra **le nouveau standard de l'imagerie**. Elle apporte une **qualité d'image et de détection** bien meilleure que celle des systèmes de vision actuels, avec en prime une **réduction de la taille, du poids et du coût** de ces systèmes.

Notre startup attire déjà les principales entreprises de l'aérospatiale, des smartphones, de l'automobile, de la réalité virtuelle... **L'équipe** est constituée d'une dizaine de personnes **jeunes, dynamiques et expérimentées** (ingénieurs mécanique, matériaux, électro-optique, designer optique, responsable production,...) qui ont **l'ambition** de relever ce **défi** en prenant **plaisir** à travailler ensemble.

SILINA doit se renforcer avec le recrutement d'un **Technicien packaging et procédés semiconducteur back-end (F/H)** en **CDI**. Le poste est situé à Gardanne (13).

Résumé du poste:

Vous êtes **responsable de la mise** en œuvre les procédures de fabrication, inspection, et test des composants, plus particulièrement de **capteurs d'image courbes**. Vous êtes en **interaction forte** avec le responsable de production, l'équipe technologie et les opérateurs salle blanche. Votre **expertise technique** sur le **packaging** des capteurs d'image (et notamment des machines pick-and-place et die bonding de type Datacon) vous permet de produire et proposer des améliorations de procédés. Vous évoluez dans un environnement de **salle blanche ISO5-8** et serez formé à plusieurs équipements de pointe.

Vos missions:

- Mettre en oeuvre les procédures de fabrication, inspection, et test des composants,
- Opérer principalement sur des étapes d'automatisation de packaging (pick-and-place, bonding, wire bonding, dépôt de cover glass) afin de garantir un procédé répétable et d'augmenter en cadence de production,
- Etre en soutien des ingénieurs et techniciens sous-traitants sur des étapes de grinding et dicing,
- Effectuer les essais en environnement (thermique, humidité, mécanique) sur les composants développés,
- Mettre en forme les résultats de fabrication, métrologie, test, ...
- Effectuer la préparation des échantillons, depuis la réception des wafers jusqu'à l'envoi au client,
- Etre acteur du processus d'amélioration continue ainsi que de la démarche qualité par des retours terrain constants



Votre profil :

- De formation Bac +2/3 en physique, chimie, matériaux, mesures physiques, ou procédés, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur les procédés semiconducteur back-end des capteurs d'image,
- Vous avez une maîtrise avancée des machines pick-and-place et die bonding (eg DATACON 2200)
- Une connaissance des maîtrises de procédés statistique (SPC), de la gravure sur silicium (RIE etching, ...), ou en décontamination et nettoyage chimique serait un plus
- Vous faites preuve de rigueur et d'attention aux détails
- Vous êtes curieux des nouvelles techniques, et pouvez apprécier des missions diversifiées tout comme des besoins de production en série
- Vous faites preuve d'un très bon relationnel

Les plus du job :

- Activités diversifiées
- Challenges techniques
- Technologie de rupture

Contact : pierre.delcroix@silina.io , wilfried.jahn@silina.io

